

## Projekt 2.3. Grid-EYE sensor Evaluation Kit enables fast prototyping of IoT and many other applications

Katarzyna Wójcik 299423

# Zawartość projektu - wymagania

---

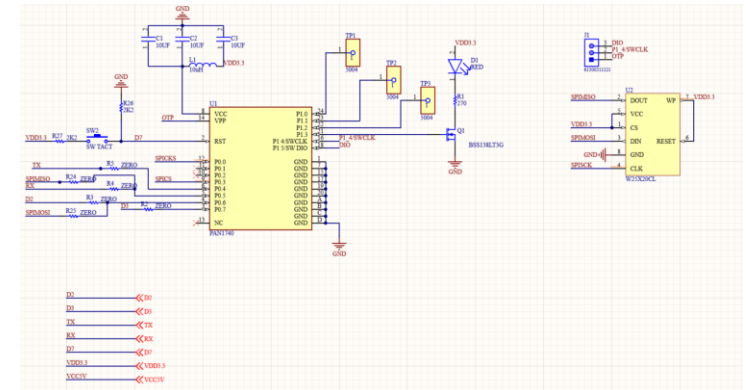
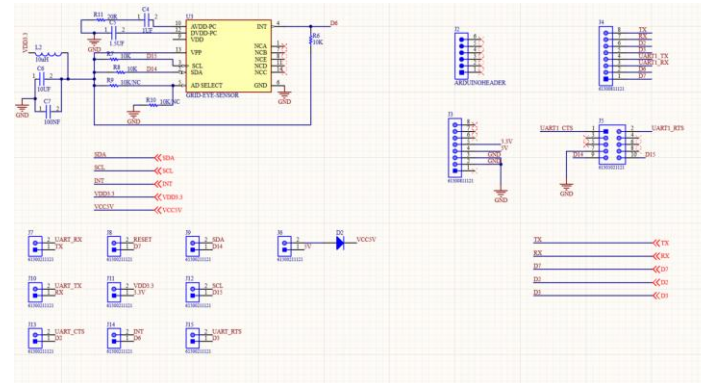
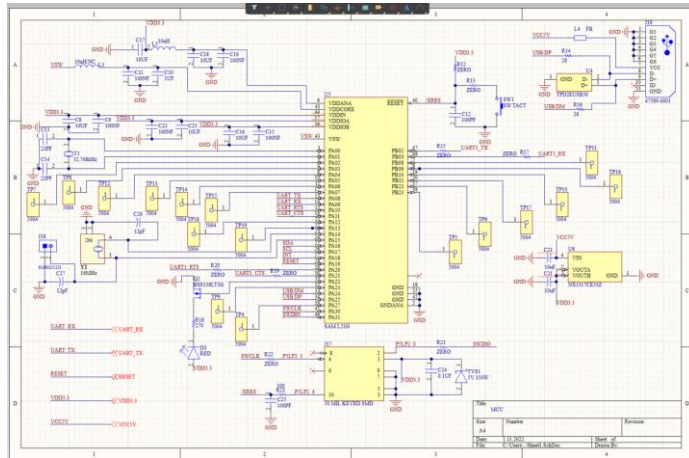
## SCHEMATY UKŁADU

Wykonanie schematu na podstawie  
gotowego projektu

## BOARD PLANNING

Wykonanie projektu płytki na 4 warstwach  
Wykonanie złącza na Raspberry Pi

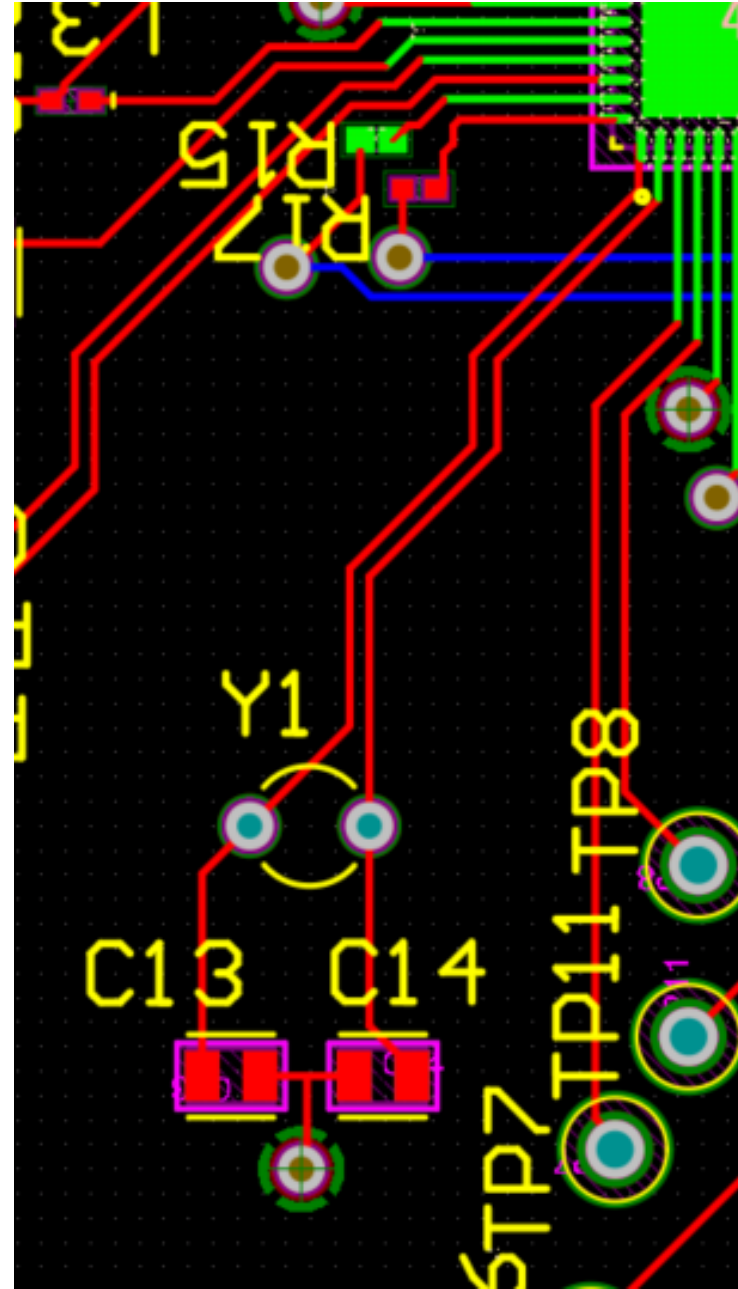
# Schematy



+ Add    Remove				Features ▼					
#	Name	Type	Thickness	#	Thru 1:4	Blind 1:2	Blind 1:3	Blind 4:2	Blind 4:3
	Top Overlay	Overlay							
	Top Solder	Solder Mask	1mil						
	Top Surface Finish	Surface Finish	0.787mil						
1	Top Layer	Signal	1.378mil	1					
	Dielectric 1	Prepreg	5.1mil						
	Dielectric 2	Prepreg	5.1mil						
2	Int1 (GND)	Plane	1.378mil	2					
	Dielectric 3	Core	28mil						
3	Int2 (PWR)	Plane	1.378mil	3					
	Dielectric 4	Prepreg	5.1mil						
	Dielectric 5	Prepreg	5.1mil						
4	Bottom Layer	Signal	1.378mil	4					
	Bottom Surface...	Surface Finish	0.787mil						
	Bottom Solder	Solder Mask	1mil						
	Bottom Overlay	Overlay							

# Warstwy i przelotki

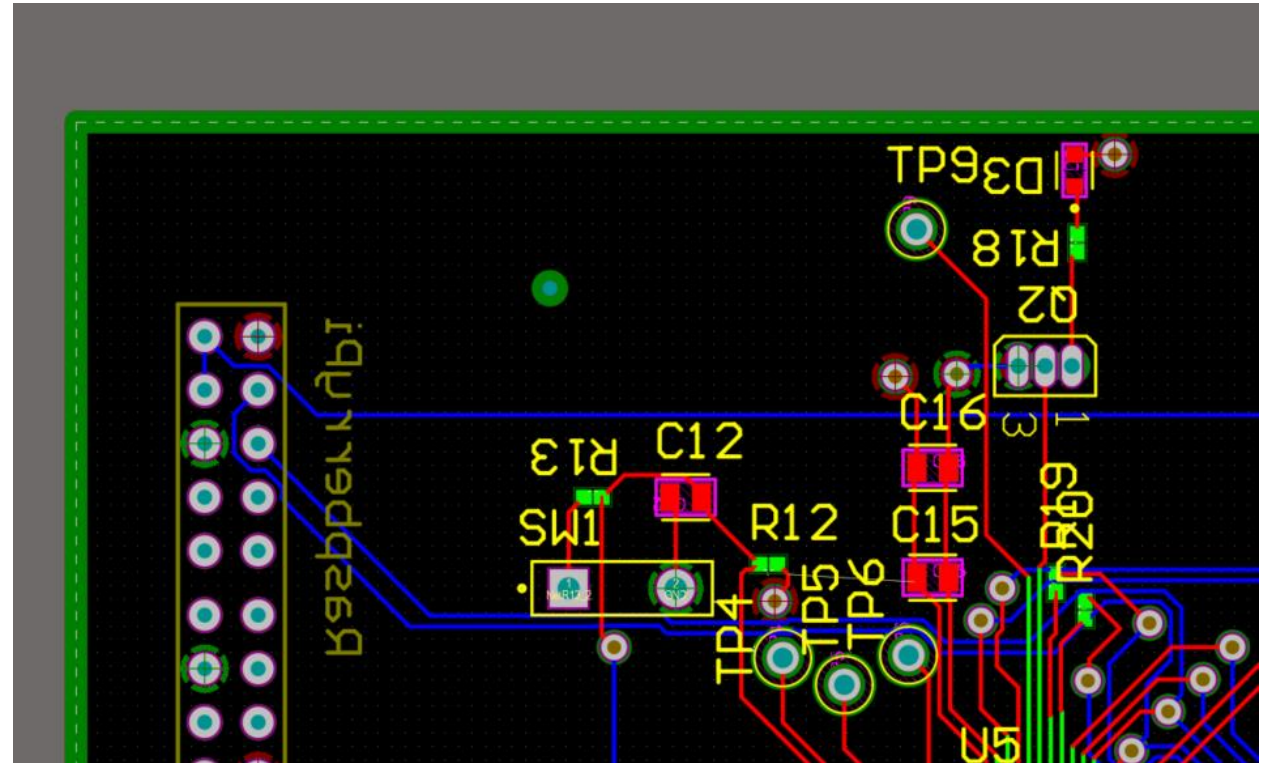
Ścieżki wysokich  
częstotliwości  
powinny się  
różnić długością  
między sobą





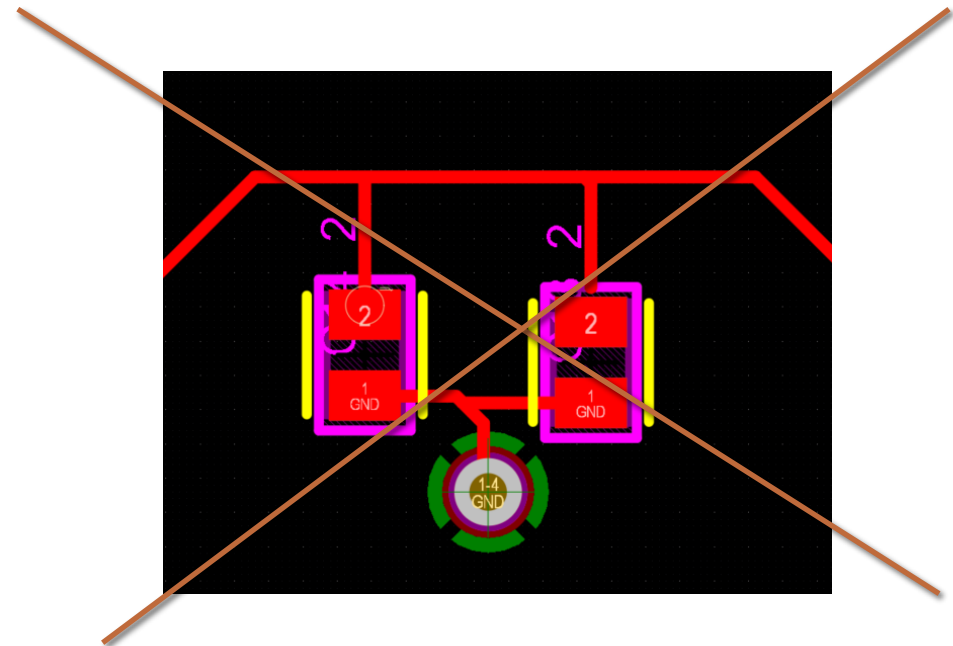
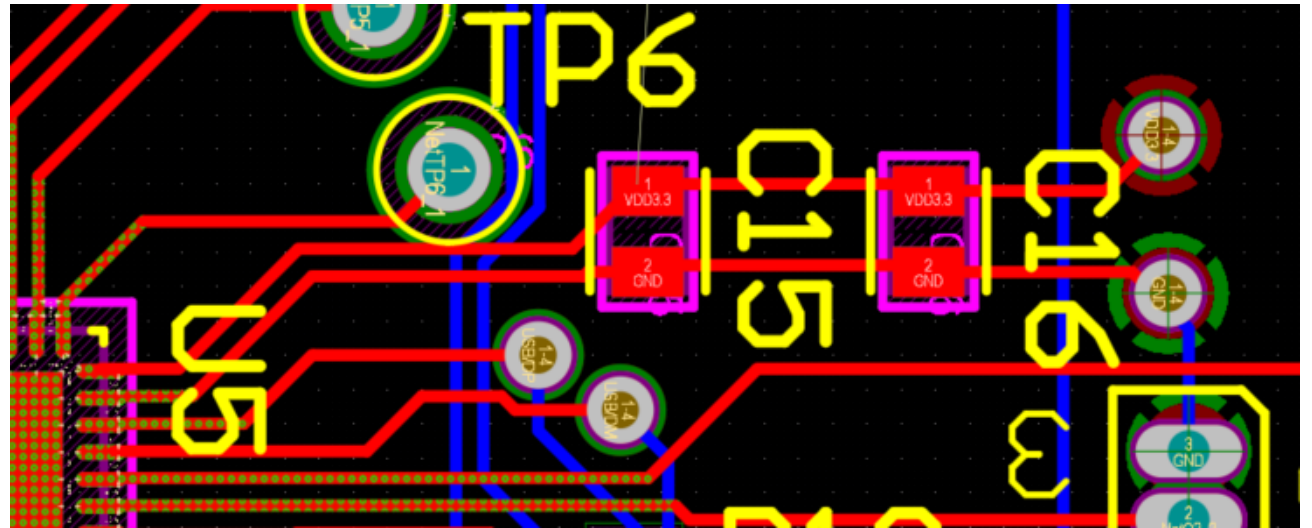
# Strategiczne rozmieszczenie mocowania

Tak aby była odporna na wibracje – uchwyty nie ułamały się, by płytką była zamocowana stabilnie oraz nie łamała się.

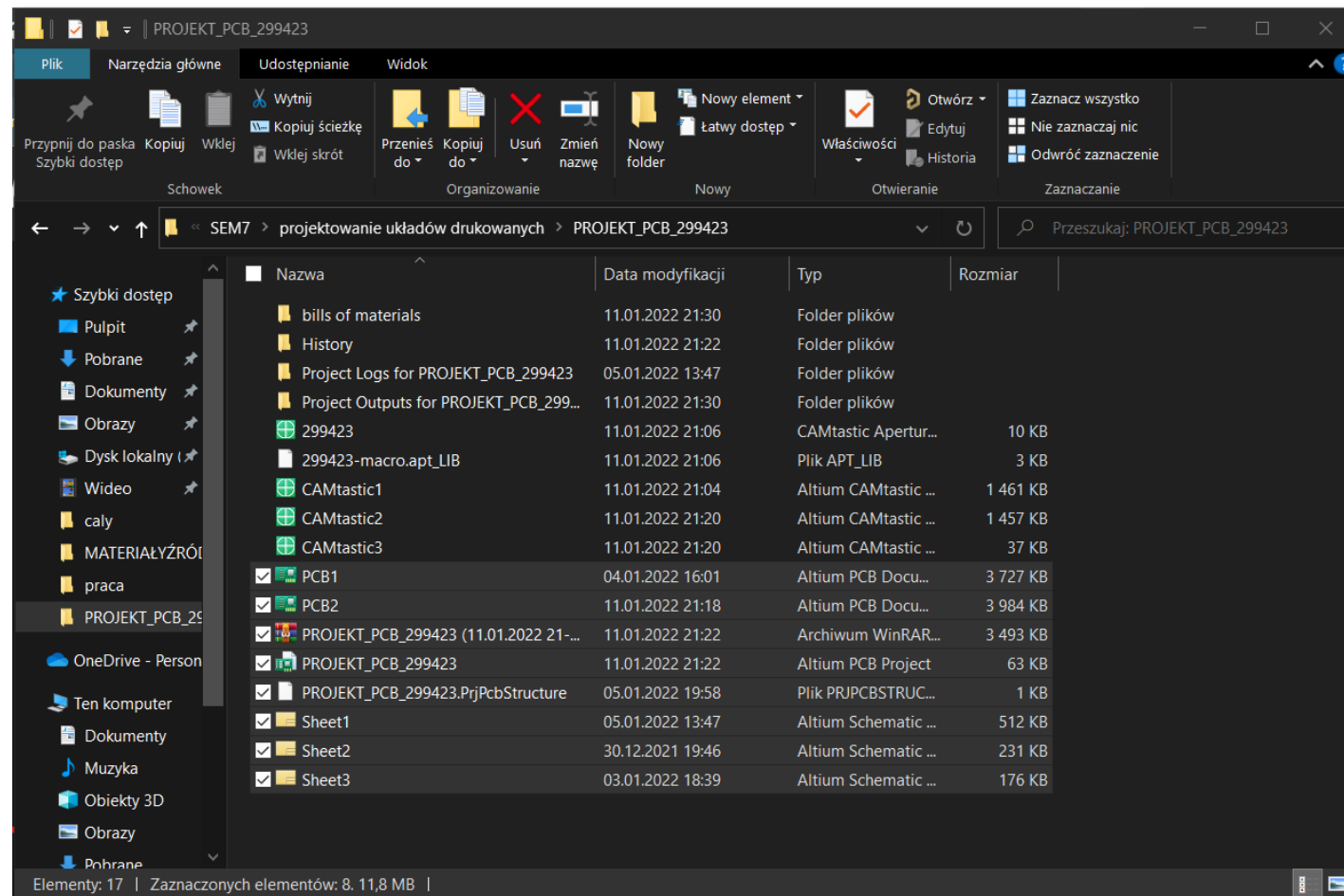


# Łączenie kondensatorów

Dodatkowo należy zmienić grubości ścieżek



# Wygenerowane pliki GERBER i BOM





# Dziękuję za uwagę

---